



高质量生产
HIGH QUALITY

全新架构
NEW ARCHITECTURE

高生产效率
HIGH EFFICIENCY

适用范围广
WIDE APPLICABILITY

- 📍 常熟经济开发区海城工业坊
- 📍 苏州相城经开区富阳工业坊
- ✉ 商务 sales@jcxj.com.cn
- ☎ 400-9280188
- 🌐 www.jcxj.com.cn



微信公众号



哔哩哔哩账号

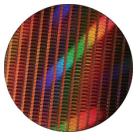


抖音官方账号

参数 PARAMETER

工作尺寸	$\Phi 8''$, $\Phi 12''$	
主轴	双轴 1.2/1.8/2.4/3.0 kW 最大 60000 rpm	
刀片尺寸	2" ~ 3"	
Y1 / Y2 轴	单步步进量	0.0001 mm
	到位精度	< 0.002 mm
	切割范围	310 mm
X 轴	进刀速度输入范围	0.1-600 mm/s
Z1 / Z2 轴	单步步进量	0.0001 mm
	到位精度	≤ 0.001 mm
θ 轴	到位精度	$\pm 15''$
清洗台	旋转速度	100-3000 rpm
	清洗方式	全自动冲洗并甩干
工作电压	三相 380V 50Hz	
设备信息	长宽高 WxDxH	1550x1255x1880 mm
	重量	2100 Kg

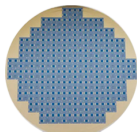
应用 APPLICATION



硅基晶圆



钽酸锂 / 铌酸锂



砷化镓



碳化硅 SiC



石英玻璃



光学玻璃

☐ 主要用于 8-12 英寸半导体晶圆、包括 Si, SiC, HBM(AI) 等多种材料领域的全自动划切加工

功能 FUNCTION

☐ 高精度非接触式测高

☐ 多片同盘双刀切割

☐ 自动校准、自动刀痕检测、刀片破损检测系统

☐ 适应不同工艺，可选多种自动对准算法

☐ 故障自动纠错功能，多种位置实时检测

☐ 首片切后检验功能

☐ 软件适配现场 FDC、RMS、EAP 系统

☐ 简化刀片管理，使用条形码阅读器输入主机